

株式会社ジェイ・イー・ティ

**2024年12月期第2四半期（中間期）
決算説明会資料**

2024年8月23日

1. 2024年12月期第2四半期（中間期）決算概況・通期予想
2. 2024年12月期トピックス
3. 今後の成長戦略

Appendix

A background image of a blue circuit board with various traces and components, overlaid with a semi-transparent blue rectangle containing the title text.

1. 2024年12月期第2四半期（中間期） 決算概況・通期予想

業績サマリー

第1Qの洗浄装置立上案件が少なく、第2Qも一部装置立上が客先の意向で下期に遅延、対前年同期比で減収減益に

売上高 9,968百万円	営業利益 587百万円	経常利益 520百万円	中間純利益 297百万円
前年同期比 ▲15.0%	前年同期比 ▲43.4%	前年同期比 ▲44.9%	前年同期比 ▲54.0%

- ✓ 地政学的な要因やインフレなどを受け、世界的な消費停滞が継続
- ✓ DRAMについては生成AI向けサーバーやGPUに多くのHBMが使用され、価格上昇。新たな設備投資も増加
- ✓ 中国を中心とした成熟世代半導体向け設備投資は継続も、一部ファウンドリにて設備稼働率が停滞。投資減速の傾向
- ✓ 通期連結業績予想も修正（2024年8月9日リリースご参照）

連結業績

計画していたコストダウン（材料費、外注費等）が進まず、
また、売上高減少のため抑制はしているものの、販管費率が上昇、利益を圧迫

単位（百万円）	2023年12月期 上期	売上比 （%）	2024年12月期 上期	売上比 （%）	対前年同期比 （%）
売上高	11,724	—	9,968	—	▲15.0%
売上総利益	2,399	20.5%	2,006	20.1%	▲16.4%
販管費	1,360	11.6%	1,418	14.2%	4.3%
営業利益	1,039	8.9%	587	5.9%	▲43.5%
経常利益	944	8.1%	520	5.2%	▲44.9%
中間純利益	646	5.5%	297	3.0%	▲54.0%

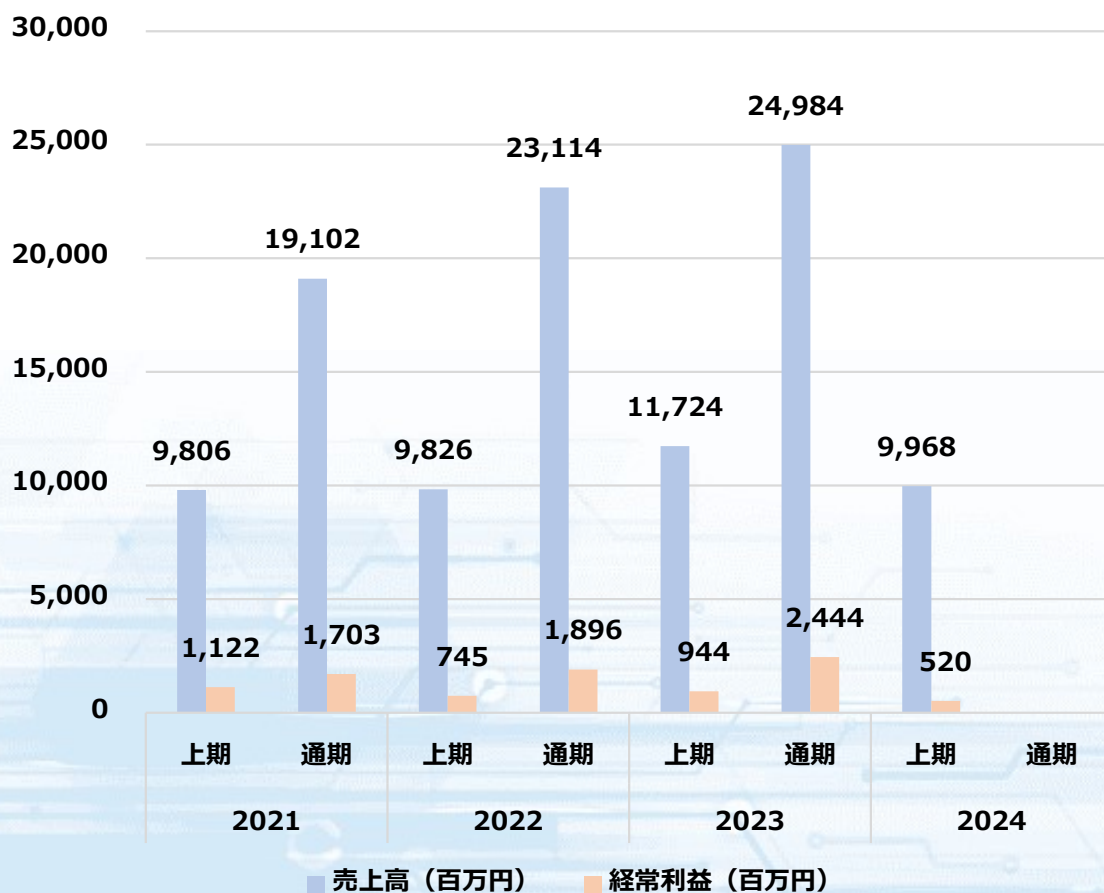
連結貸借対照表

単位（百万円）	2023年12月期	2024年12月期 上期	増減	主な増減要因
流動資産	27,068	26,375	▲693	「現金及び預金」の増加 「仕掛品」の減少
有形固定資産	954	1,013	59	
無形固定資産	56	92	36	
投資その他資産	695	746	51	
資産合計	28,774	28,228	▲546	
流動負債	11,496	11,175	▲321	「短期借入金」の増加 「前受金」の減少
固定負債	4,866	4,623	▲243	「長期借入金」の減少
負債合計	16,362	15,799	▲563	
純資産合計	12,411	12,429	18	「利益剰余金」の減少
負債純資産合計	28,774	28,228	▲546	

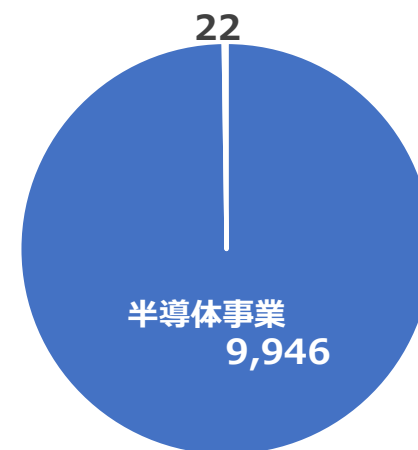
売上高・経常利益推移 売上構成

洗浄装置立上遅延などの影響で業績は踊り場に

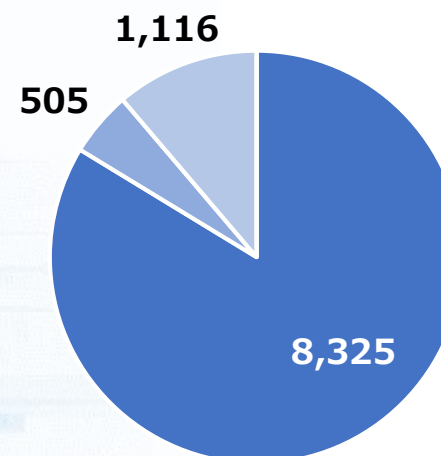
売上高・経常利益推移



セグメント別連結売上高



半導体事業内訳



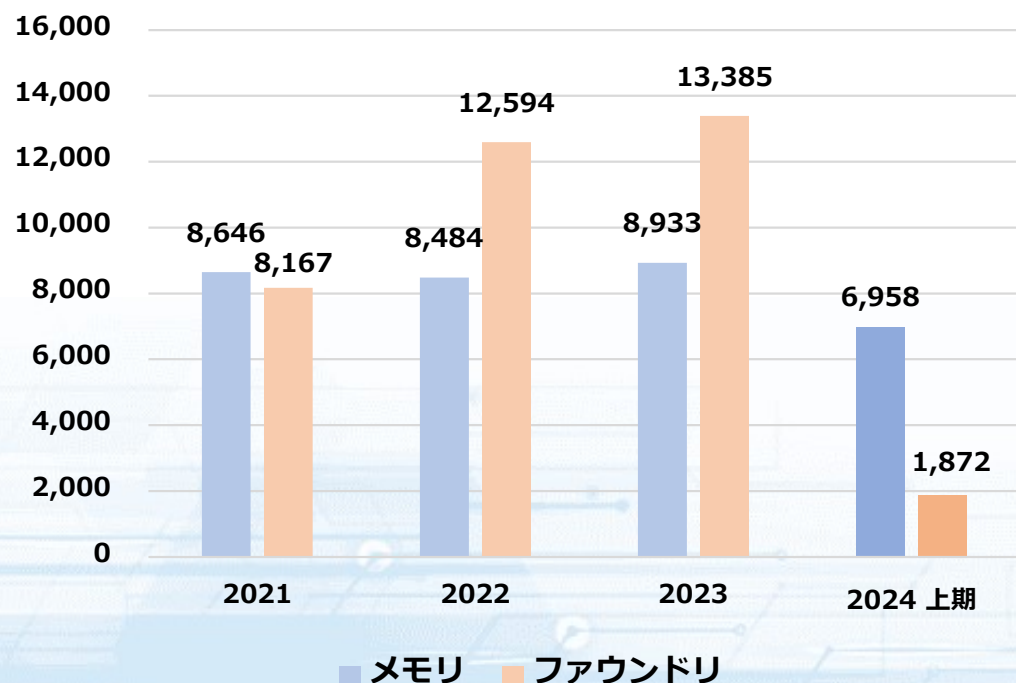
2024年12月期
上期実績

■ バッチ式 ■ 枚葉式 ■ フィールドサービス ■ その他

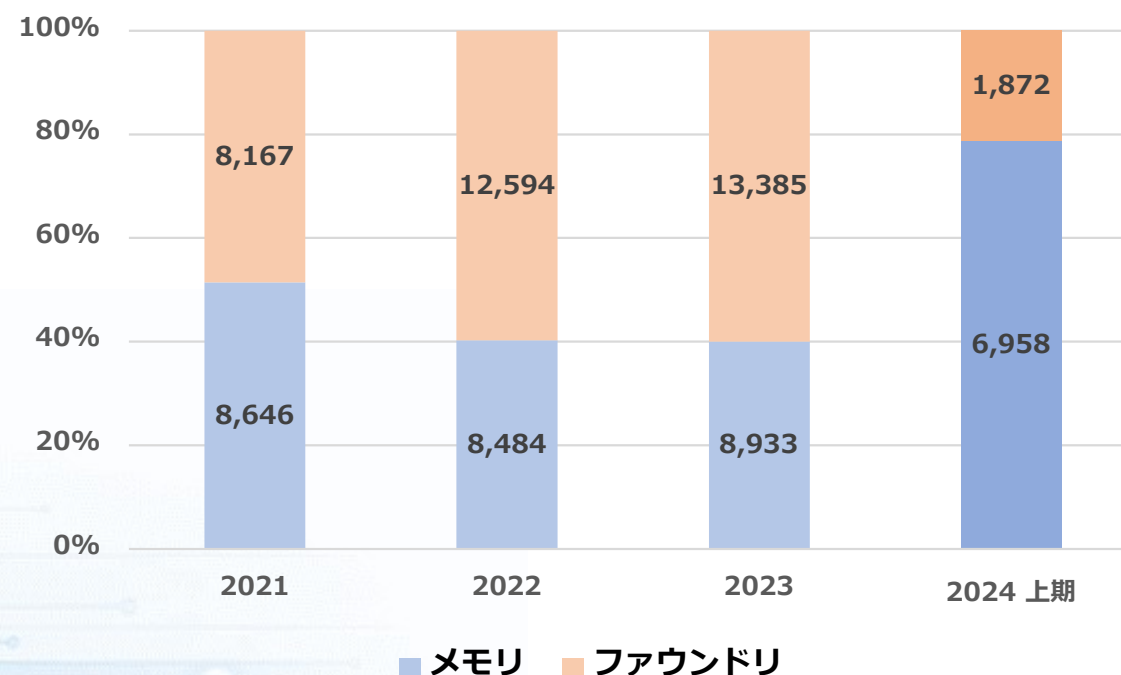
装置売上高推移（仕向け先別）

2024年12月期 上期についてはメモリ向けの売上構成が高い

装置売上高仕向け先別推移



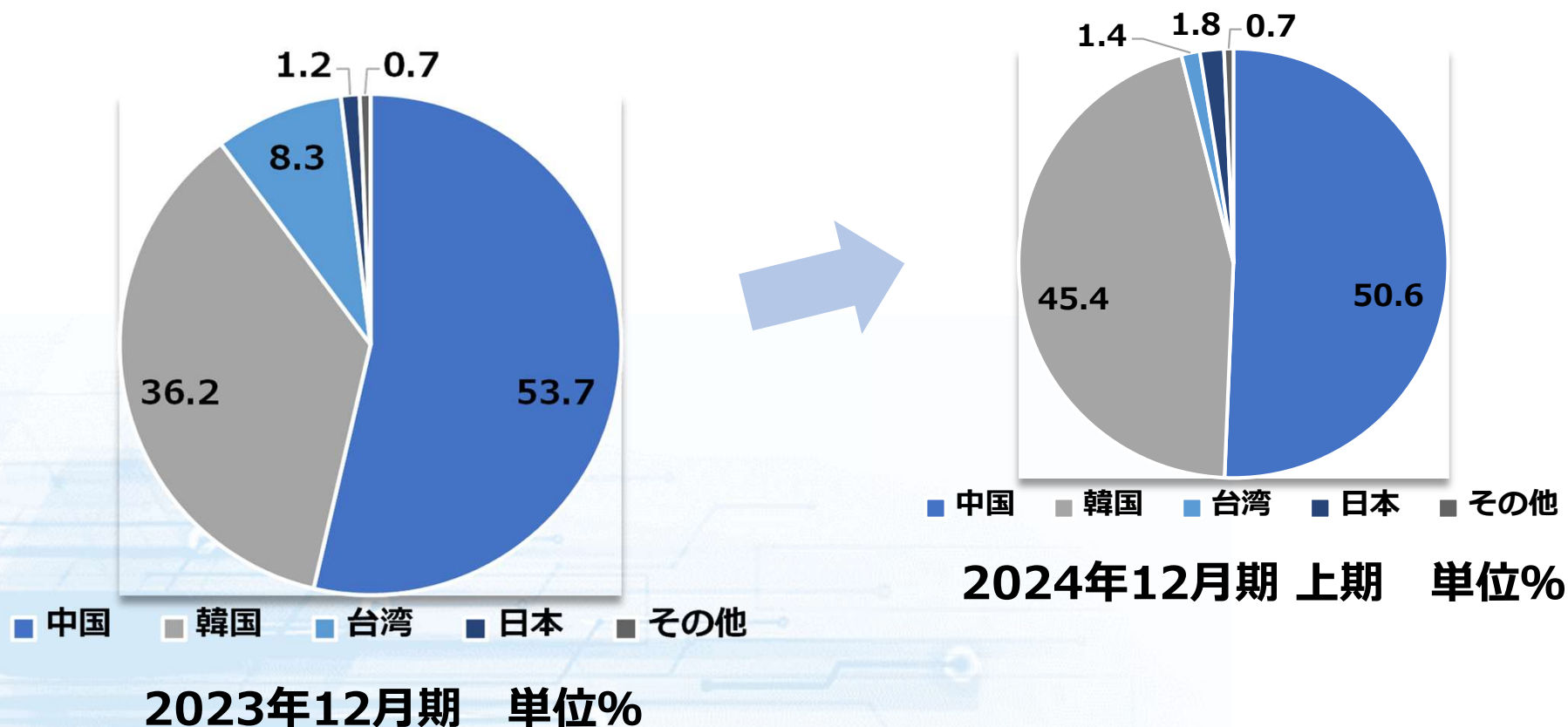
装置売上高仕向け先別構成比推移



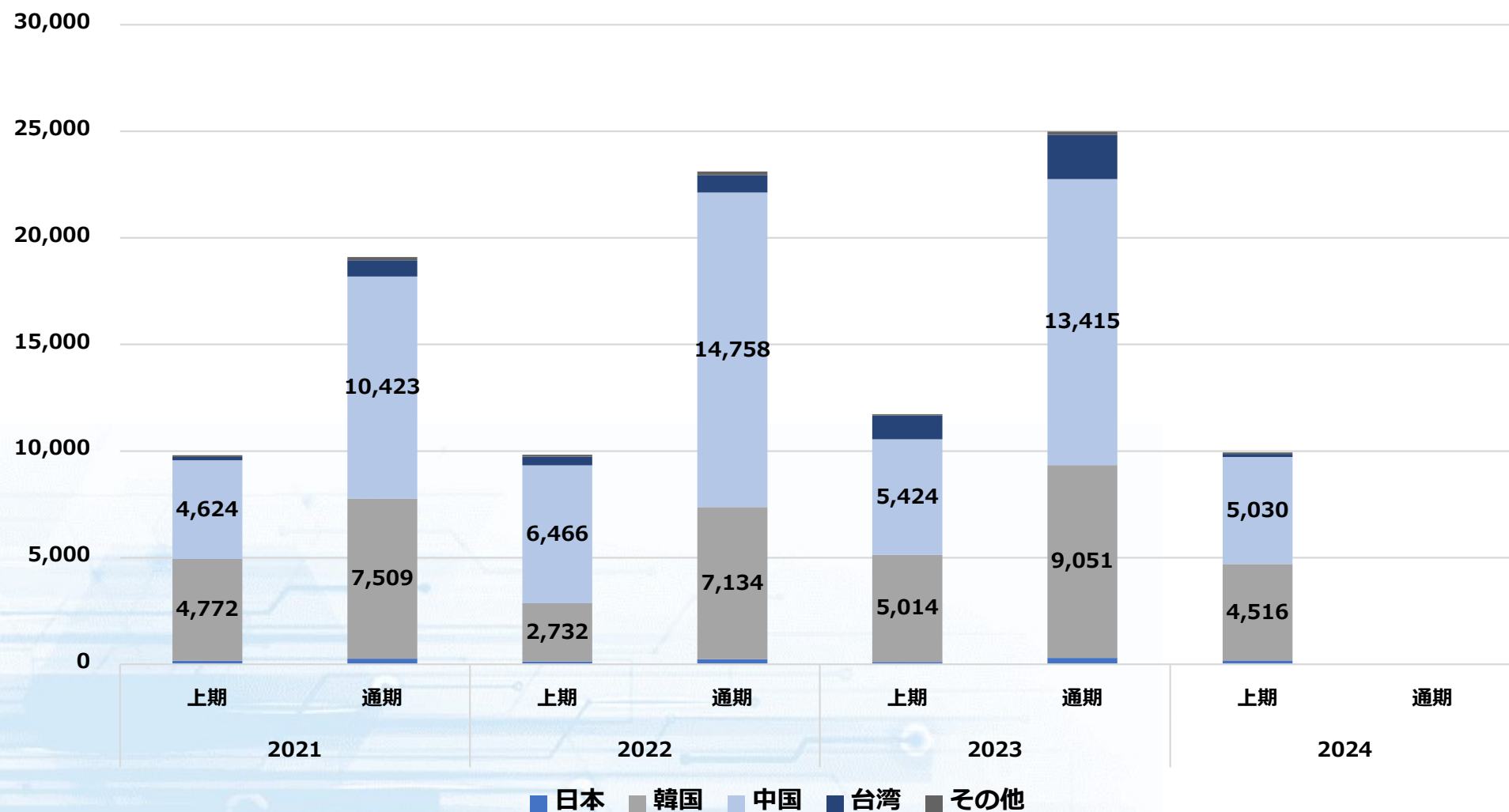
地域別売上高構成比推移① 前期比較

2024年12月期 上期は韓国、中国向け中心の売上構成

* 将来的には中国、台湾、韓国、米国・日本でそれぞれ25%の構成比を目指す



地域別売上高構成比推移②



- ✓ 欧米のインフレは落ち着きつつあり金融政策も金融緩和の時期を探る段階に入るも、引き続き地政学的なリスクなど受け不透明要因の多い市場環境
- ✓ エレクトロニクス製品を含む世界的な消費停滞も継続
- ✓ 半導体市況においては想定されていた**2024年からの市況回復が後ずれ**
- ✓ DRAMにおいては生成AI向けサーバーやGPUにはHBMが使用され、**DRAM価格は上昇、新たな設備投資も増加**
- ✓ 成熟世代半導体向けの設備投資は、米中関係の緊張もあり中国で継続も、**一部ファウンドリで設備稼働率が停滞、投資減速の傾向**
- ✓ 中国市場においては成熟世代半導体領域で新興洗浄装置メーカーとの競争も増加

通期業績予想

通期ベースでも想定以上に洗浄装置立上遅延が増加、想定していた新規受注も後ずれ当初予定したコストダウン（材料費や外注費等）も時間を要しており、予想を下方修正

<p>売上高 21,480百万円</p> <p>前期比 ▲14.0%</p>	<p>営業利益 1,460百万円</p> <p>前期比 ▲44.1%</p>	<p>経常利益 1,350百万円</p> <p>前期比 ▲44.8%</p>	<p>当期純利益 900百万円</p> <p>前期比 ▲45.5%</p>
--	--	--	---

- ✓ **韓国メモリーメーカー向け、米国ファウンドリ向け、中国ファウンドリ向けで洗浄装置立上が遅延**
- ✓ **売上高減少と製品構成の変化、材料費・外注費のコストダウン未達などで減益に**
- ✓ **上期受注でのカバーを意識し営業に注力するも、市況の停滞感や現地新興洗浄装置メーカーとの競合などからカバーできず**
- ✓ **なお受注残はあり、次の飛躍に向け充電するこの期に、顧客ニーズに対応した装置開発や製造体制強化に注力**

A detailed, stylized illustration of a blue circuit board with various traces, pads, and components, serving as a background for the slide.

2. 2024年12月期 トピックス

次の成長に向け、幾つかの成果を実現

1. Rapidus 次世代半導体製造技術の研究開発受託

基礎研究開発業務（α機）を完了
試作装置製作に関する研究開発業務（β機）に移行

2. 「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」採択

「新本社工場建設による生産力拡大・生産性向上・研究開発の加速の実現」事業

3. 戦略機種 BW3500 販売開始

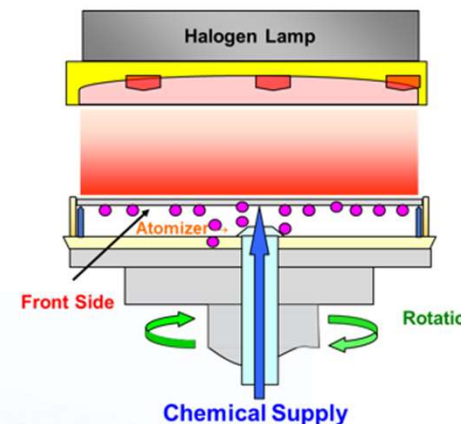
300mmウェハ対応バッチ式洗浄装置
BW3000後継機種ながら自社製品の置き換え需要だけでなく、
28nm以上の設備投資を意識し、他社製品からの切替、需要掘り起こし
現地新興洗浄装置メーカーに対する技術優位の確立を企図

トピックス Rapidus社からの開発業務受託

- Rapidus社はIBMと戦略的パートナーシップを締結し、2nm半導体の開発・生産を目指す
- Rapidus社は**多品種少量生産で「どこよりも速い」半導体製造**の実現を目指し、**全枚葉式**を軸としている
- 製造装置は基本的にIBM社ラインの装置が導入されるが、**リン酸エッチング処理についてはIBM社ラインに枚葉式がなく、別途開発が必要となっている（当社が開発中）**
- 現状、研究開発段階（ α 機）を終え、試作装置製作に関する研究開発（ β 機）段階
- 当社は2027年量産ラインへの当社装置納入を目指す



Rapidus千歳工場（IIM）
 2023年9月起工
 2025年試作ライン立ち上げ、
 2027年量産ライン立ち上げ予定



HTS-300

ご参考：当社枚葉式装置

新本社・工場建設にかかる事業で、中堅・中小成長投資補助金事業として採択 事業資金に対し上限50億円、補助率1/3以内

01. はじめに 公募要領 > 1.事業概要 > (1) 事業の目的
> (2) 補助上限額(補助率)

事業概要 02/37



本補助の目的

地域の雇用を支える中堅・中小企業の皆さまが、人手不足等の喫緊の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現できるよう支援すること

投資規模
10億円以上が対象

補助上限
50億円 (補助率1/3以内)

概要	
公募期間	令和6年8月9日(金)17:00まで 2次公募 受付中
採択発表	令和6年9月中下旬を予定
申請方法	jGrants(ジェイグランツ)による電子申請 ※電子申請以外の申請は不可

賃上げをして従業員のモチベーションを高めたい。

拠点を増やして事業を拡大させたい。

最新の設備を導入してもっと生産性をあげたい。

補助事業の背景・目的

- ① 生産能力の問題：
生産改革を実現するためのスペースを確保し、生産能力の向上を図る必要があった
- ② 生産性の問題：
 - ・ 洗浄装置1台製造するのに必要な部品は2~3万点。生産数の増加に伴い、従来の人力による部品の保管・管理・ピッキングでは非効率となっている
 - ・ 本社工場で部品保管する場所が不足し外部倉庫を賃貸、コスト増加に繋がっている
- ③ 研究開発の問題：
薬液の給排管が実験機1台分しかなく、同時並行で実験を行えない
(顧客対応や開発スピード遅延の原因)

→ 補助事業で新本社工場を建設し、①~③の問題を解決する

設備投資の内容

- 事業実施場所
 - ・ 岡山県 (敷地は約2.5ha)
- 設備投資の内容
 - ・ 本社工場の新築
 - ※ 面積拡張により作業スペースを拡大
 - ※ 部品管理、製造プロセスの省人化・効率化を図る
 - ※ 研究開発室を拡張し3台同時に実験可能に
 - その他、製造に必要な設備一式を導入
(例：工作機械、純水設備、荷受・荷出設備 等)

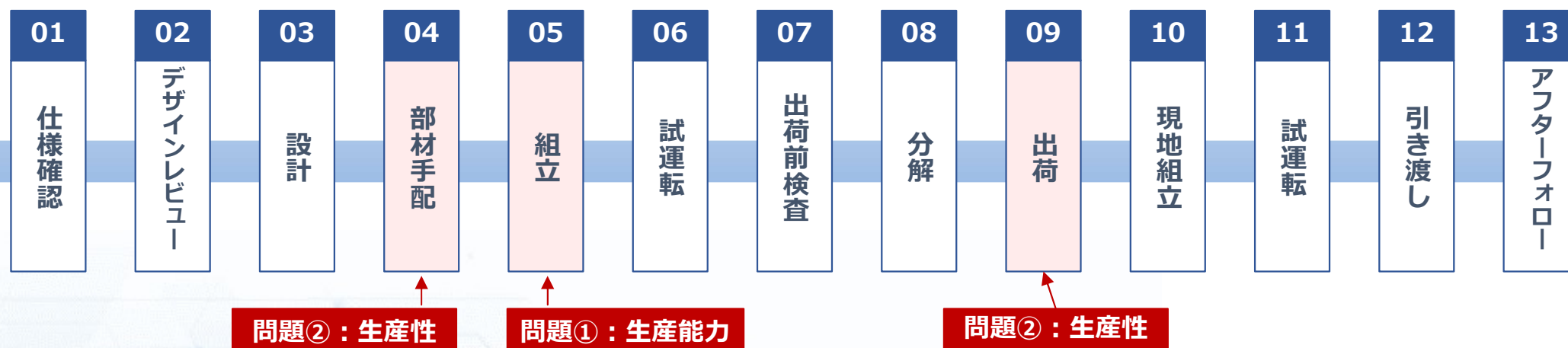
投資予定額
75億円



トピックス 生産性についての問題点

<製造フロー>

- 当社の製造フローについて、顧客とすり合わせ設計後、部材を手配し組立・試運転を行う。
- 問題なく動作することを確認した後、分解し、飛行機もしくは船舶で据付場所に輸送、現地へ作業員を派遣し組立てを行う。
- 組立後、試運転を行い問題なく動作することを確認した後に引き渡し。その後、適宜アフターフォローを行う。



<研究開発フロー>



- 当社の研究開発は、以下の2つを指す。
 - ・ 新規技術・製品の開発
 - ・ 既存設備の更新時におけるカスタマイズに係る研究開発
- どちらの研究開発においても、実験機を用いた実験が必須である。
- 実験では薬液（硫酸、リン酸等）を使用するため、薬液供給・廃液回収のシステムが必須となる。

トピックス 新工場建設による課題解決

問題①：生産能力		問題②：生産性	
生産改革の実現	荷入場・出荷場	部品ピッキング	部品保管場所の不足
<p>現状</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在の製造場所（クリーンルーム）の広さでは、同時に製造できる装置数は10台 1台の装置を製造するのに要する標準時間は4カ月前後につき、最大で年間30台の生産能力 堅調に受注増加する中、生産能力が不足しつつあり、納品に時間を要するため、タイムリーな受注獲得が出来なくなっている 	<ul style="list-style-type: none"> 工場が手狭になり増改築を繰り返した結果、荷入場・出荷場にトラックを寄せられないケースが発生している（特に荷入場） 荷入場・出荷場は地面と同じ高さで、また狭いため、荷役作業効率が悪い 現在はフォークリフトを駆使して対応しているものの、物の移動中の破損リスクが高い 	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄装置の製造には1台当たり2～3万点の部品が必要 現在はバーコードを活用し人力で部品保管・ピッキングしているが、部品点数が多く作業効率が極めて悪い 受注拡大に伴い同時に保管が必要な部品点数が増加、何とか保管している状況で、動線が悪くっており、作業効率が悪い 	<ul style="list-style-type: none"> 受注拡大に伴い同時に保管が必要な部品点数が増加 洗浄装置は幅2m×奥行7m×高さ2mと大型のため、大型サイズの部品もある 工場も手狭になり保管場所が不足。広島県東広島市に外部倉庫を賃借しているが、コスト増加やリードタイム伸長の要因となっている
 <p>装置製造場所は10台のみ</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>入荷場</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>出荷場</p>  </div> </div>	 <p>部品保管（バーコード管理）</p>	 <p>保管場所が不足し、外部倉庫を活用中</p>
<p>補助事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 生産改革を実現するためのスペースを確保し、生産能力の向上を図る 生産改革を実現することで短納期化とタイムリーな受注獲得を実現する 	<ul style="list-style-type: none"> 新本社工場では入荷場・出荷場の導線を整備するとともに、ドックレバラー等を導入 荷役作業効率向上を図るとともに、荷役作業中の破損リスク低減を実現する 	<ul style="list-style-type: none"> 新本社工場では保管場所を拡大するとともに自動ピッキング装置を導入 省人化・効率化を図り、より付加価値の高い工程へ人員を割くことで、生産性向上を実現する 	<ul style="list-style-type: none"> 新本社工場建設後は、現本社工場を倉庫とし、外部倉庫を集約する なお、現本社工場は緊急的な生産拠点としても活用可能

主力機種BW3000が開発から20年を経過、より顧客ニーズに応えられる後継機種として、**BW3500を開発**

- 今後投資の中心になる**28nm以上のプロセスをターゲットに**
- RCA洗浄の他社製品からの切替を意識

BW3000からの改善点

1. フットプリントの削減
(装置面積にて15~16%、装置全長で20%の削減)
2. 新たな搬送方式の採用
(搬送アームに加え、Moving / Single Liferによる搬送)
3. 環境・安全対策
(OHT専用PORTの設置、薬液霧困気漏れ軽減の機密性向上)
4. 破損防止対策 (樹脂槽の採用)
5. 操作性向上 (操作画面の大型化、カラー化、情報量アップ)

ほか、ONE BATH、メタルイオン対策、新排気システム、薬液使用量削減、スループット向上、新乾燥システムの採用などを実現



BW3500

高精度プロセスへの対応が特徴

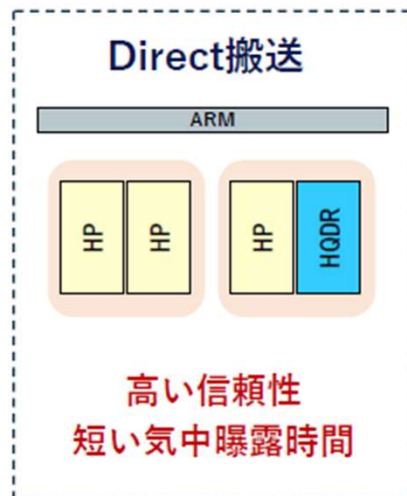
3. BW3000との比較 -Comparison with BW3000-



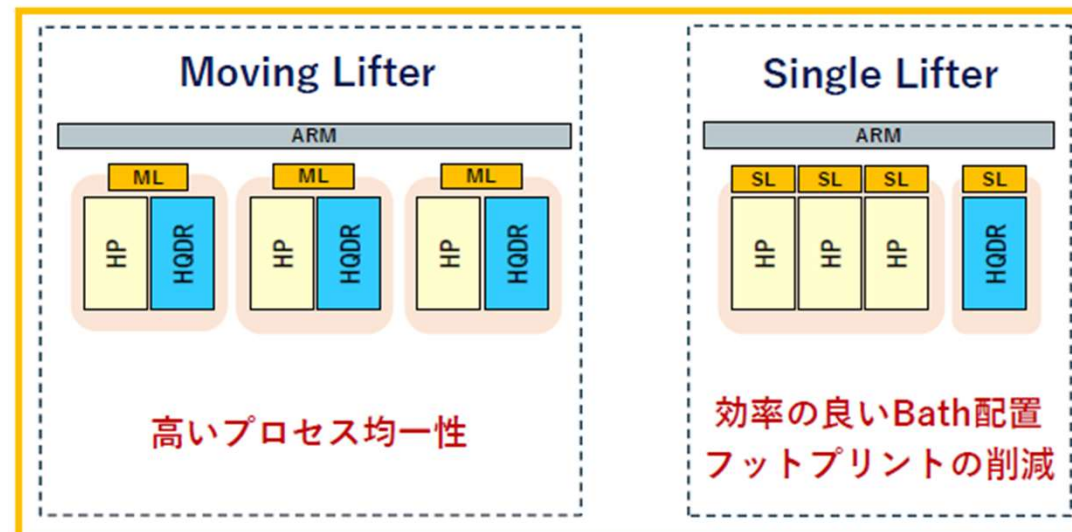
■ 新モジュール構成追加による高精度プロセスへの対応

JET標準の薬液槽連続配置に加え、プロセスクリティカルな工程に対してはChemical+DIWを基本モジュールとしたBath間差の無い構造を選択することが可能

BW3000



BW3500 (組み合わせ可能)



出所：当社営業資料より

トピックス BW3500 エリア戦略 東アジア

中国、韓国、台湾など主要エリア戦略の要となるBW3500の開発を終え、販売を開始

中国

1. SMICグループとの関係維持
2. 既存顧客（ファウンドリ、メモリ）の増産への対応
3. **BW3500による他社装置からの切替促進**



韓国

1. **BW3500のサムスンでの拡販**
2. SiC装置対応強化
(他エリアへの横展開)
3. 新HTSでの拡販

台湾

1. TSMC向けHTS/03の対応を優先
(他エリアへの横展開)
2. 既存顧客との関係維持
3. **BW3500 による他社装置からの切替促進**

The background of the slide is a detailed, stylized illustration of a blue circuit board. It features various traces, pads, and components, with a glowing effect that gives it a sense of depth and technology.

3. 今後の成長戦略

長期連結業績（売上高・営業利益）推移

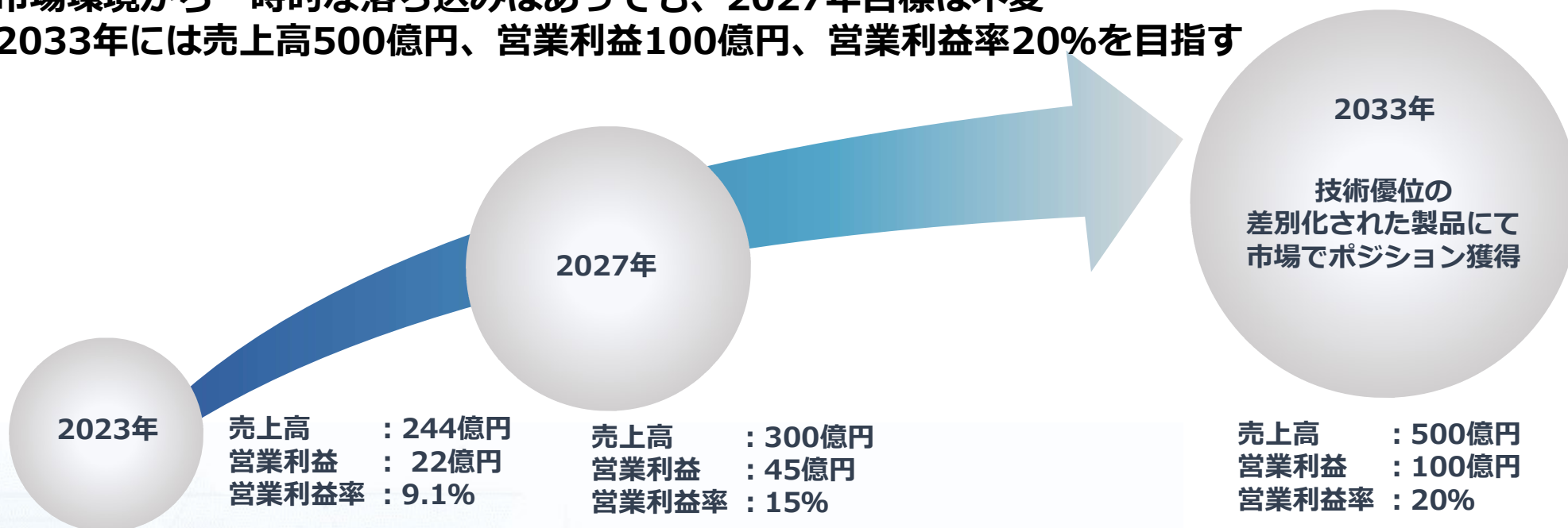
シリコンサイクルの影響を受けながら、これまでも半導体需要の増加に伴い成長
2024年は我慢の年度になるも中長期的な成長を期す



* 2019年以前の数字は監査法人による監査を受けていない参考数字

中長期 数値目標と4つの軸での戦略

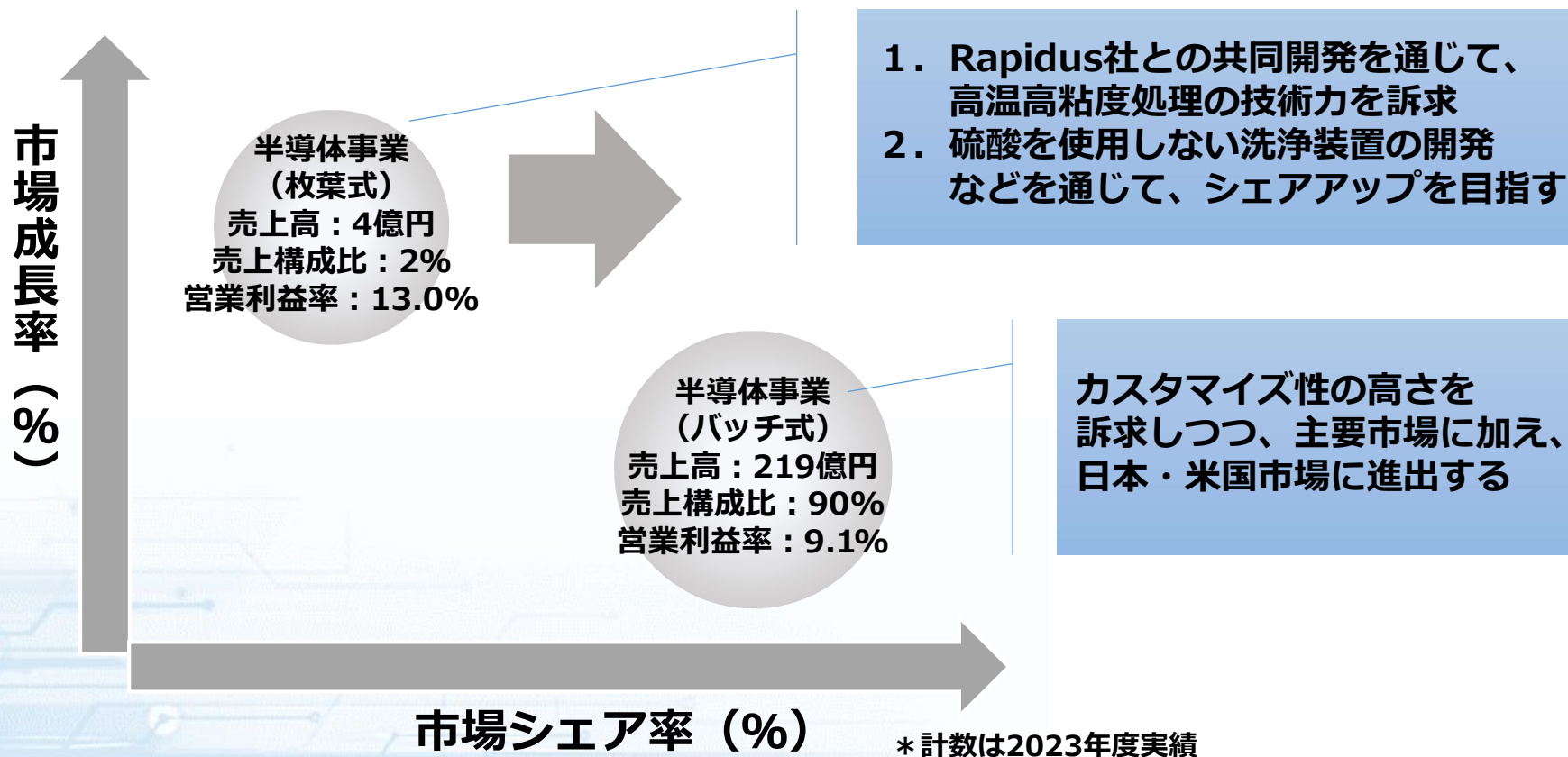
市場環境から一時的な落ち込みはあっても、2027年目標は不変
2033年には売上高500億円、営業利益100億円、営業利益率20%を目指す



製品戦略	エリア戦略	組織戦略	製造戦略
<ul style="list-style-type: none"> ・ バッチ式洗浄装置 処理槽の構成や設置数の カスタマイズ性の高さを訴求 ・ 枚葉式洗浄装置 高温高粘度薬液への対応を 推進し差別化を図る ・ GXへの対応 硫酸を使用しない洗浄装置の 開発等GXへの対応を行う 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主要市場(韓国、中国、台湾) 既存のリレーションを通じ取 引濃化を進める ・ 米国市場 : 現地法人を開設、 "レガシー半導体領域"での顧 客開拓に注力 ・ 日本市場 : 日本の優位性が高 い車載用半導体や、国内回帰 を進めるメーカーの開拓強化 	<ul style="list-style-type: none"> ・ システムデザイン部の新設 当社の強みは、カスタマイズ 性の高さと高温高粘度処理の 技術。房野社長の指導の下、 一流の技術営業部隊を育成し、 質の高い提案型営業を実現す る ・ 営業強化 : 米国へは初めて、 日本へは15年ぶりに進出。商 文化の違いを踏まえ顧客開拓 	<ul style="list-style-type: none"> ・ サプライチェーン強化 景気変動の影響を強く受ける 半導体業界において、生産能 力の弾力化は必須。 協力会社との関係を強化し、 ファブレス化を推進する ・ 新工場建設 : 生産能力の拡大 や生産効率化、R&Dの強化を 企図し新工場を建設する

戦略 成長への事業ポートフォリオ整理

バッチ式のシェアを守りつつ、差別化された枚葉式洗浄装置で成長を期す



- バッチ式洗浄装置は、今後も一定の市場規模を維持しつつ、半導体市場の成長に伴い緩やかに市場成長する見通し
当社は世界シェア11%を占めており、今後も市場シェア率の拡大を目指す
- 枚葉式洗浄装置は、今後も主要な洗浄装置である可能性が高く、半導体の市場の成長に伴い大きく市場成長する見通し
当社は高温高粘度処理に対応した枚葉式洗浄装置の開発・販売を通じて、市場シェアの拡大を目指す

製品戦略

地球環境問題にからみ硫酸を使用しない洗浄装置のニーズは大きい
この領域での開発に注力

新HTS

1. 硫酸以外のプロセス対応
2. 薬液（プロセス）別製品型式対応
3. リン酸は日本で実績を → 横展開
4. 03は台湾で実績を → 横展開



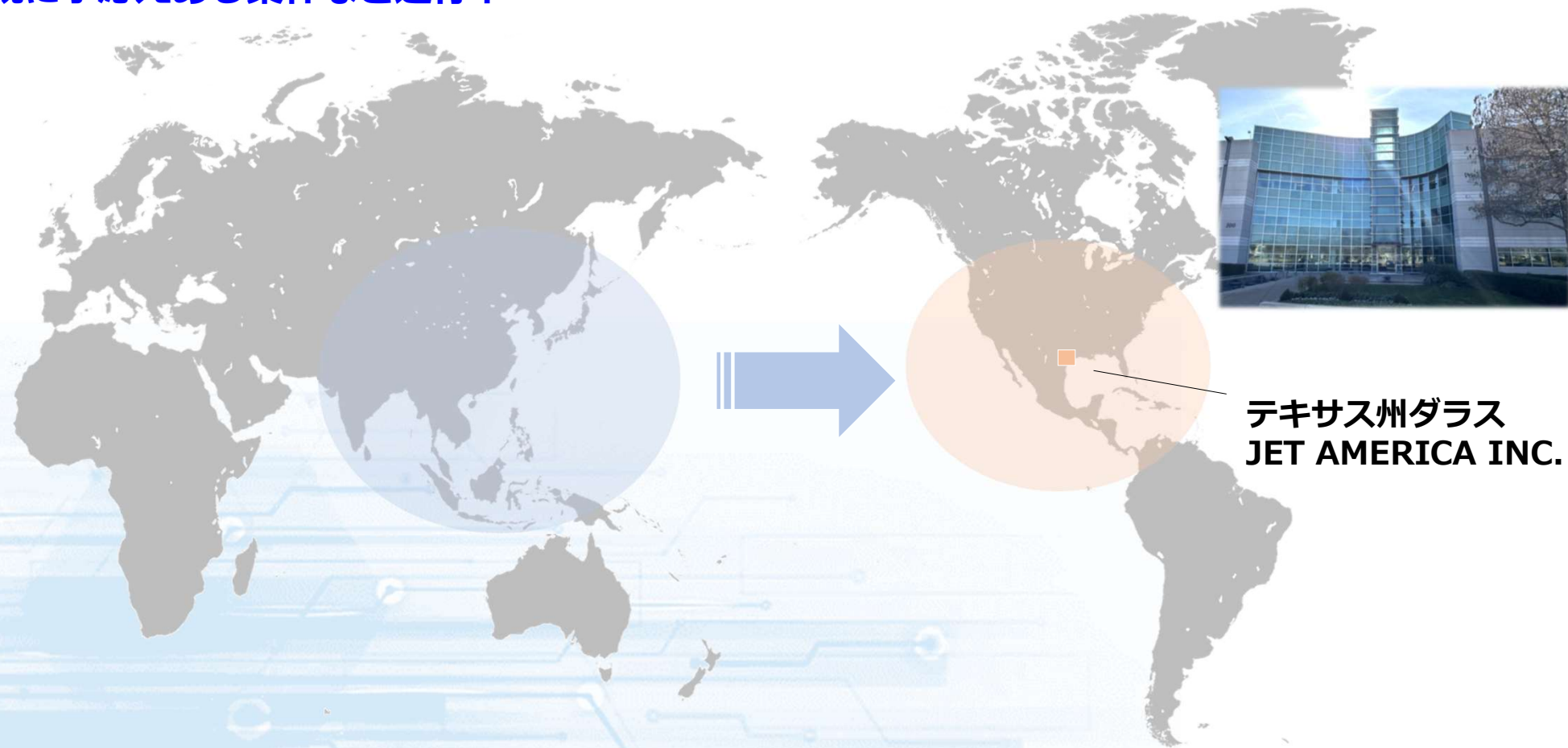
HTS-300

SiC対応装置

1. サムスン電子向けにて実績を → 横展開

エリア戦略 北米での市場開拓

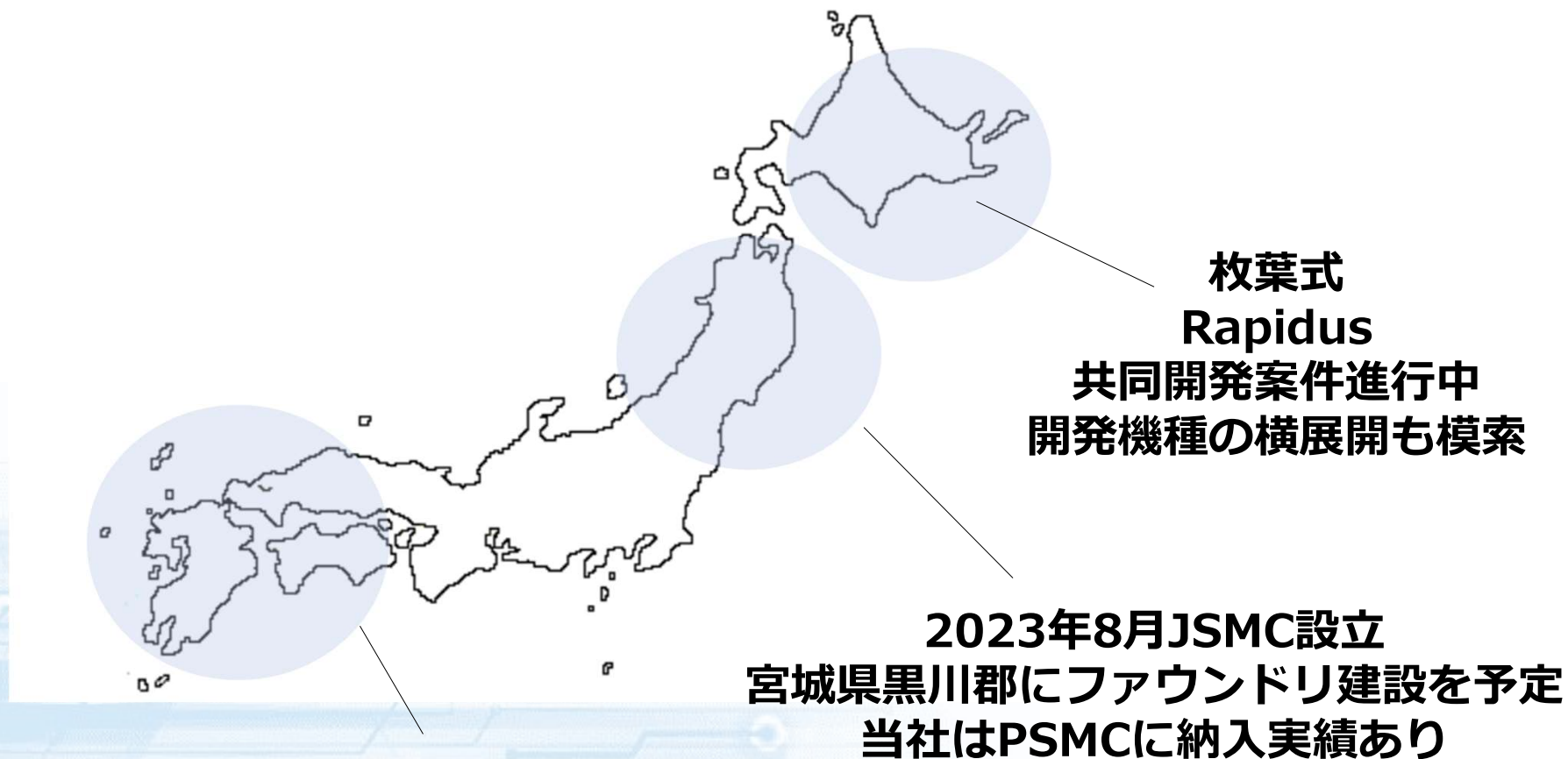
サムスン電子テキサス・テイラー工場向け洗浄装置を既に受注
この受注を足掛かりに2023年10月拠点を開設、特にレガシー領域での顧客開拓に注力
既に手応えある案件など進行中



テキサス州ダラス
JET AMERICA INC.

エリア戦略 日本での市場開拓

サムスン電子実績の横展開を強め、国内顧客の開拓等に注力中



様々な半導体関係の投資案件が集中
車載及びパワー半導体向け顧客の開拓に注力

A dark blue rectangular box containing the word 'Appendix' in white, bold, sans-serif font. The background of the slide features a complex, glowing blue circuit board pattern with various traces and components.

Appendix

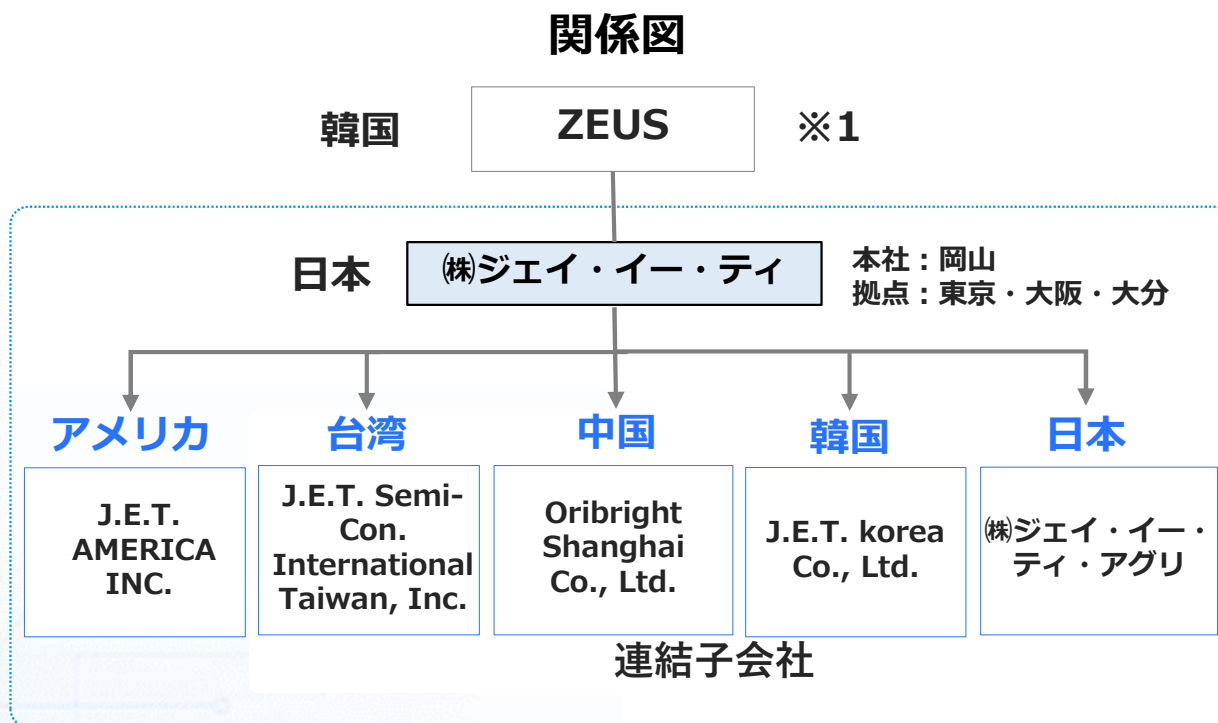
リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身
同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、
 販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD. (以下、「ZEUS」) の全額出資のもと、
 2009.4.24に設立、2009.5に**エス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生**

■会社概要

会社名	株式会社ジェイ・イー・ティ
英訳名	J.E.T. Co., LTD.
設立	2009年4月
資本金	1,848百万円 (2023年12月31日時点)
所在地	岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
T E L	0865-69-4080
代表者	代表取締役社長 房野 正幸
従業員数	171名 298名 ※連結会社含む全従業員数 (2024年6月30日時点)
事業内容	半導体洗浄装置の開発・製造・販売・ アフターサービス等
主要納入先	サムスン電子 (韓国) SMIC (中国)

グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



※1 韓国取引所KOSDAQに上場

所在地: 大韓民国 京畿道華城市

資本金: 15,530,995千KRW

事業の内容: 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

当社の議決権の保有割合(%): 66.4% (直接)

関連当事者との関係: 営業取引

取引の内容: 双方より部品・材料等の販売・仕入及び装置製造業務委託、当社よりZEUSへ販売手数料支払い等

* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

- 国内拠点
- 海外拠点



韓国拠点 29名

J.E.T. korea Co., Ltd.

- Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社



中国拠点 75名

* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(HEAD Office) 台湾本社



台湾拠点 27名

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(Singapore branch) シンガポール支社

シンガポール 3名

九州出張所(※1)

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※3)

本社 (岡山)



- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供。
- ※2 大阪事務所は、LIB製品の営業を担当。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培。



JET AMERICA INC.

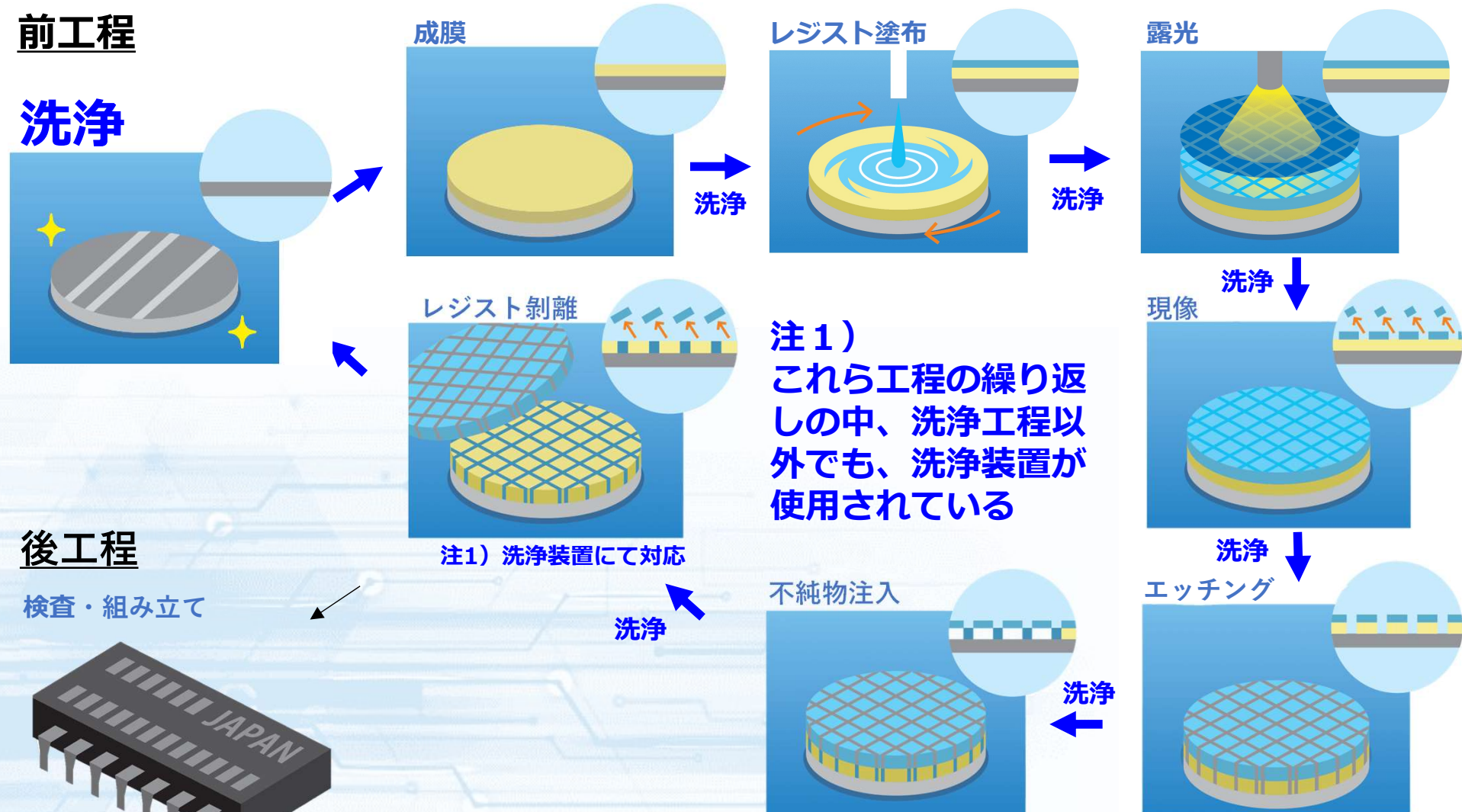
米国拠点 3名

半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

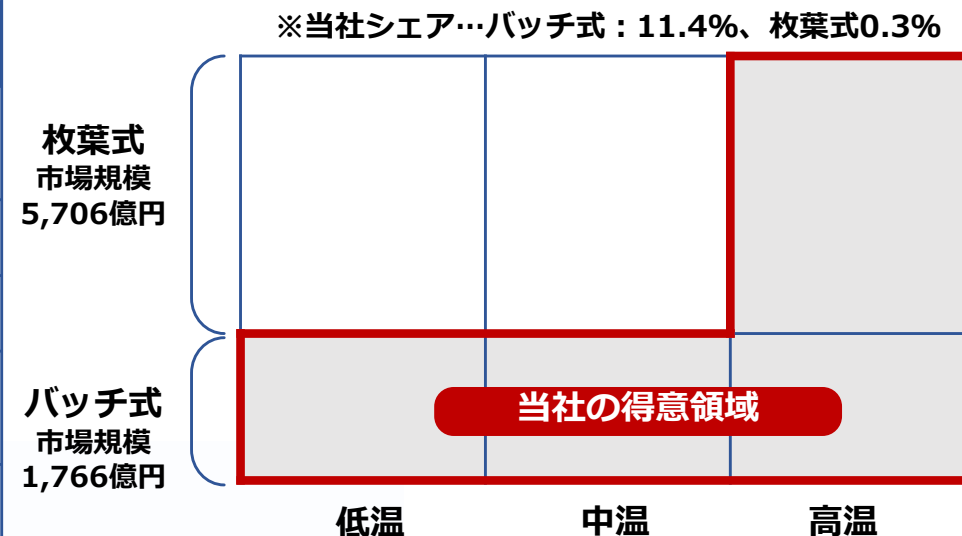
前工程

洗浄



半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社の得意領域

		バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要		25～50枚のウエハを一括洗浄	ウエハを1枚ずつ洗浄
長所		生産性が高い	精密な洗浄が可能
短所		ウエハの塵を拾い易い	生産性が低い
現状		生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主流洗浄装置
高温高粘度 処理	特徴	プロセス温度維持が容易	プロセス温度維持が難しい
	硫酸	○ (主流)	△ (一部対応)
	リン酸	○ (主流)	× (対応なし)
市場規模 (2022/世界)		1,766億円 (当社シェア 11.4%)	5,706億円 (当社シェア 0.3%)



競合状況と差別化要素

半導体洗浄装置は、2000年代以降日本企業が70%以上のシェアを持つと考えられており、特にA社、B社の存在感が大きい

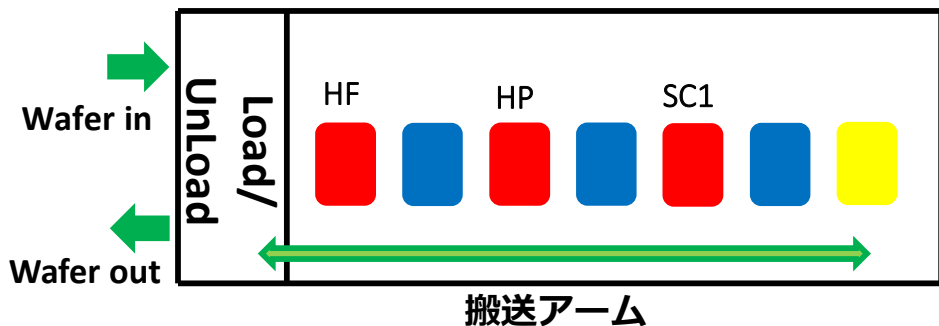
		当社	A社	B社
会社規模 (直近期売上高/営業利益)		244億円 (22億円)	4,608億円 (765億円)	2兆2,090億円 (6,177億円)
シェア (2022年度の 市場規模)	バッチ式 (1,766億円)	11.4% (202億円)	47.8% (835億円)	28.8% (508億円)
	枚葉式 (5,706億円)	0.3% (11億円)	48.5% (2,170億円)	28.3% (1,523億円)
技術	RCA洗浄	△	◎	○
	硫酸洗浄	◎	○	△
	リン酸洗浄	◎	○	△
	その他	○	△	○
生産能力		△ (量産能力は低い)	◎ (量産能力あり)	◎ (量産能力あり)
カスタマイズ性		◎ (カスタマイズ性に強み)	△ (標準化装置に強み)	△ (標準化装置に強み)

(出所) 経済産業省「令和5年6月 半導体・デジタル産業戦略」より、評価は当社独自の認識

- 当社の競合他社は、売上規模が数千億円～数兆円の大企業で、高品質で標準化した装置を量産できる点が強み
- 当社は量産能力に劣るものの、難易度の高い高温高粘度処理やカスタマイズ性の高さに強みがある
大企業が参入しづらいニッチ領域へ、小回りの利く当社が参入し、シェアを獲得している状況

JETバッチ装置の優位性 → 唯一F-Typeを持つ

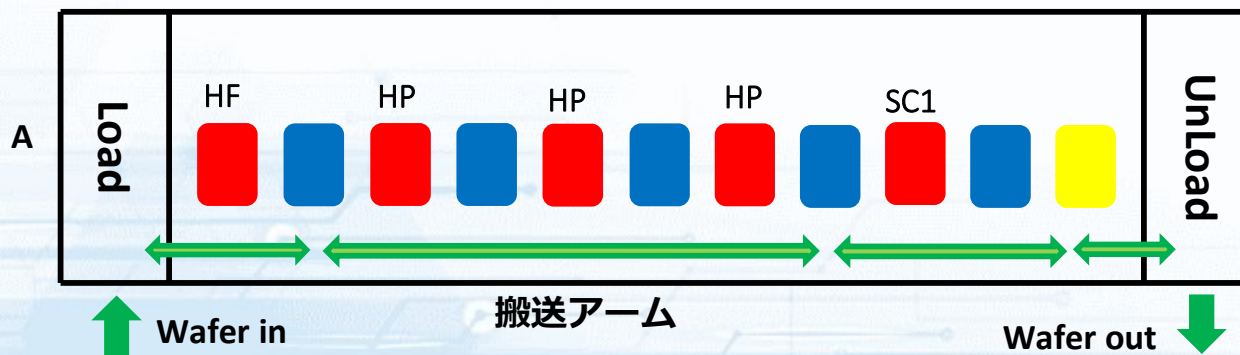
I-Type A社 / B社 / 当社



特徴

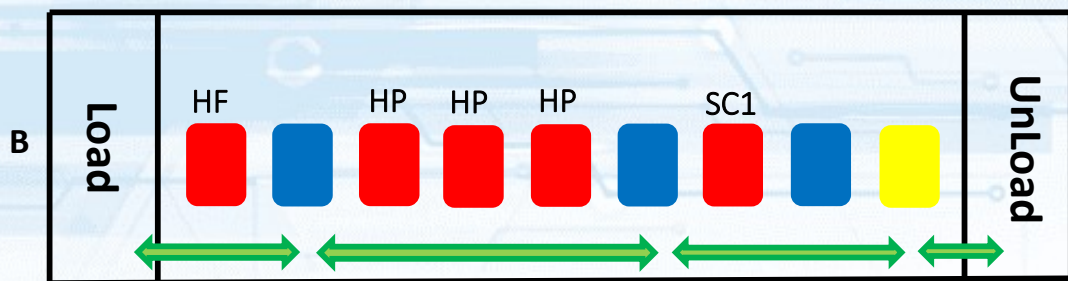
- コンパクト
- 処理槽 MAX 8 槽
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- スループット 最大250w/h

F-Type 当社のみ



特徴

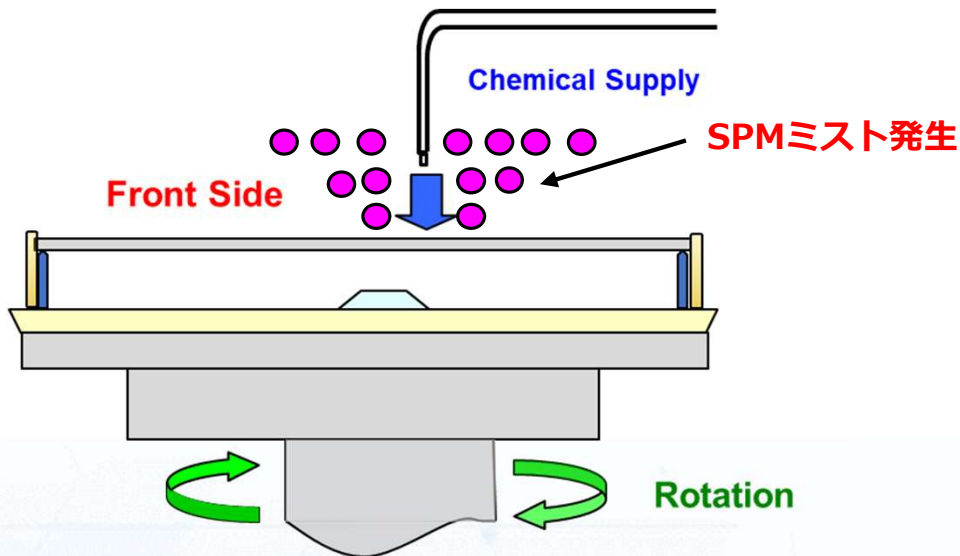
- 少し大きい
- 処理槽 MAX14槽
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- A/B 選択可能
- Bはケミカル槽を連続配置可能
- 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- **スループット 最大 500w/h**



* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

当社 枚葉式装置の優位性

A/B社 枚葉式SPM装置



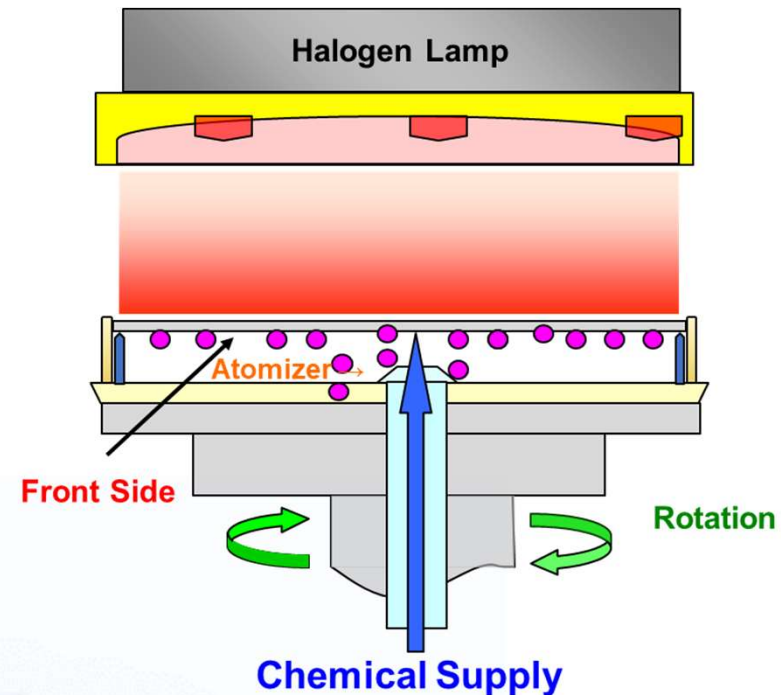
特徴

- 処理温度：150~200℃
- ケミカルの反応熱を利用
 - ➡ケミカルをかけ続けるも、高温維持は難しい
- プロセス時間：5min/HDIレジストウエハ (注)
- ➡必要ケミカル量：3000ml/ウエハ
(5分間ケミカルをかけ続ける必要がある為)
- SPMミストによりパーティクル発生量が多い

* HDIレジストウエハ=硬化層付きのレジストウエハ



* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

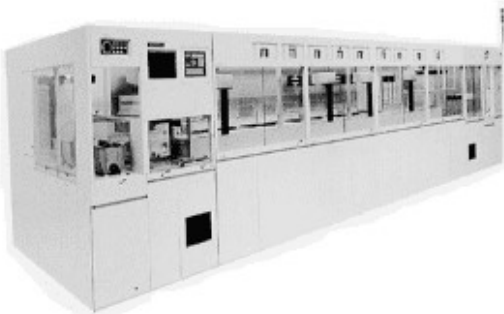

当社 枚葉式SPM装置 (HTS-300)



特徴

- 処理温度：200~240℃
- ハロゲンランプにて高温維持可能
- 処理面を反転し、霧状にしたケミカルを使用
- **プロセス時間：0.5min/HDIレジストウエハ**
 - ➡**必要ケミカル量：150ml/ウエハ**
- SPMミストが拡散せず、パーティクルの発生量が少ない

	BW3000	BW3700
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（洗浄槽の配列、数量を任意に対応可能） ◎生産効率の向上 ◎500WPHに対応する高速LD/ULD ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎二酸化炭素の低減 ◎気体流量のコントロールを実現 ◎標準化仕様化を進め、立上タイム短縮 ◎SEMI standardに対応 ◎EES（EDA or TDI）に対応 	<ul style="list-style-type: none"> ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎排気システムの個別配管により各処理槽の処理能力を安定化 ◎ウエハ間ピッチ7mm処理の実現 ◎ウエハの接触部の縮小化の実現によるパーティクル（微細なゴミ）の発生を減少 ◎気泡発生の低減化を実現 ◎リバースフローシステムにより液置換効率を向上 ◎濃度の安定性を向上 ◎豊富な処理槽種類に対応 ◎1薬液プラス1DIW構成に対応
価格帯 (平均単価) (百万円)	210~400	320~560

	BW2000	HTS-300
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 200mmウエハ対応	枚葉式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 高い生産効率 ◎ 高い洗浄能力 ◎ 省フットプリント ◎ 顧客要求に応えるフレキシブルな構成（処理槽の構成、数量の変更に対応） 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 最小150ccの薬液消費量での処理を実現 ◎ 最高240℃での高温処理を実現 ◎ 最短30秒でのストリップ処理を実現 ◎ ウエハ反転処理によるヒューム（薬液の蒸気）拡散防止の実現
価格帯 (平均単価) (百万円)	150～210	330～540

注意事項

本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2024年8月9日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しの変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ
経営統括本部

TEL 0865-69-4281